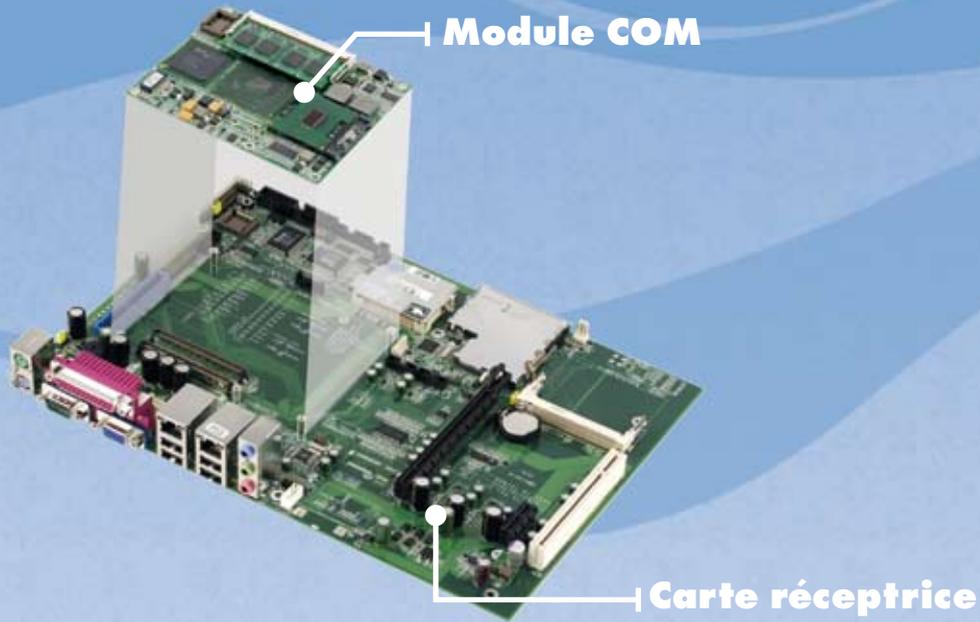




*Département
Modules & Systèmes
Informatiques*



Computer On Module

- ▶ Réduction du coût de votre développement
- ▶ Installation, maintenance et mise à jour simplifiées
- ▶ Diminution des risques inhérent à un développement
- ▶ Disponibilité sous 30 jours de votre produit



▶ Applications :

- Terminaux de vente & Affichage Dynamique
- Médical
- Appareils de mesure & tests en ligne
- Terminaux de jeux
- Automatisation industrielle & contrôle de procédés
- Militaire & Police
- Vidéosurveillance numérique
- IP TV
- M2M
- Géolocalisation
- Serveurs informatiques

MEON



Notre service ODM DTD

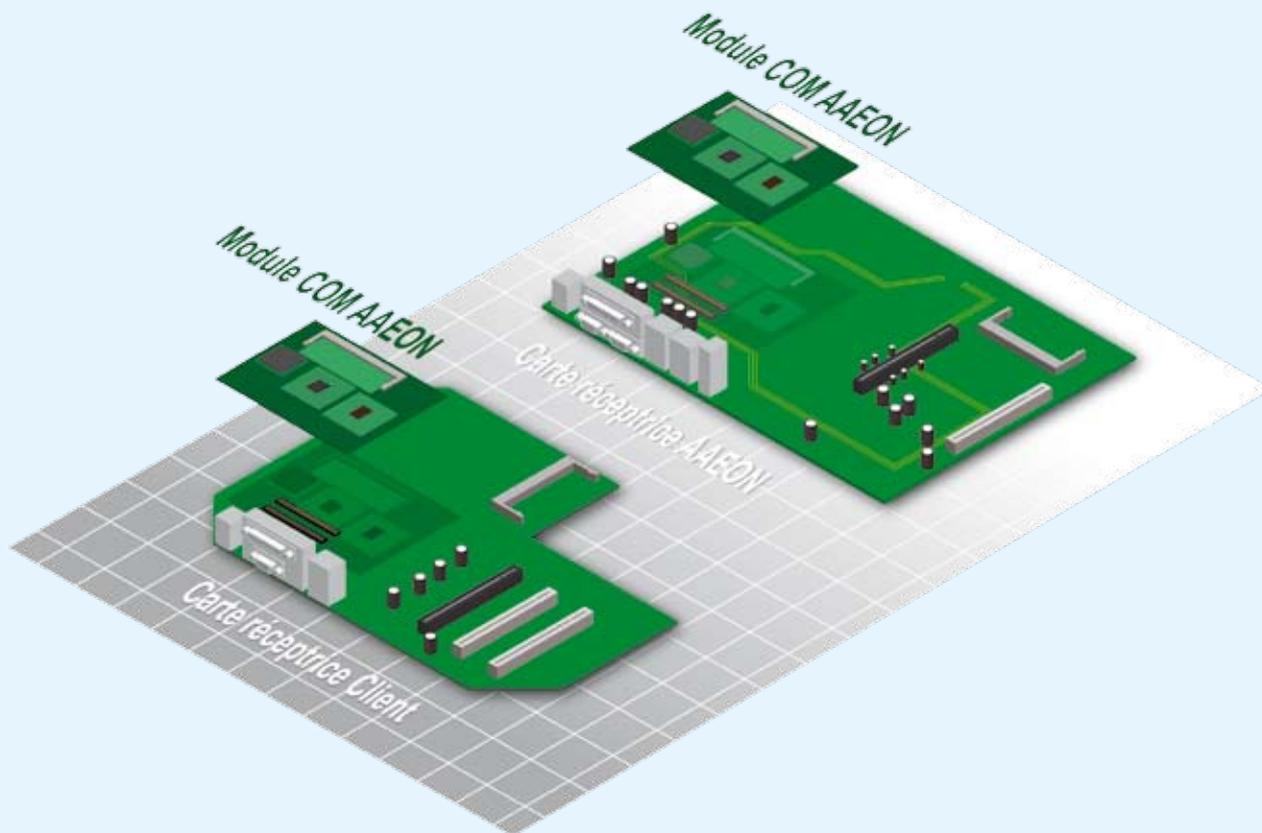
■ Les règles générales du service ODM DTD :

- Le service ODM DTD n'est assuré que dans le cadre de l'utilisation des modules AAEON aux formats : ETX, XTX and COM Express modules.
- Les frais d'études pour la réalisation de la carte réceptrice sont basés sur les spécifications arrêtées avec le client à la signature de la commande. Toute modification de ces spécifications par la suite pourra entraîner des frais supplémentaires à la charge du client. La fourniture d'une carte réceptrice sous 30 jours ouvrés est incluse dans les frais d'études. Les corrections nécessaires après le test du prototype sont prises en charge par le service ODM DTD. Ces corrections seront vérifiées par le client avant le démarrage de la pré-série.
- Dans le cadre d'une production, la quantité minimale demandée en commande est de 100 pièces. Le délai standard pour la production et les tests est de 6 à 8 semaines à réception de la commande du client.
- Dans le cadre du service ODM DTD, il sera demandé au client de s'engager à produire au moins les 300 premières pièces au travers d'Equipements Scientifiques. Pour ces 300 premières pièces, les prix unitaires pourront être revus à la hausse ou à la baisse en fonction de la quantité de carte commandée annuellement.

- Le fabricant s'engage à gérer l'achat et le stockage des composants courant qui permettent la fabrication d'un Computer On Module. Dans le cas où la fabrication de la carte réceptrice requière des composants spécifiques ou sujet à des minima de quantité en commande (MOQ), le client s'engage à acheter et à consigner ces composants chez Equipements Scientifiques.

Définitions	1 jour
Etude du circuit	5 jours
Routage du PCB	9 jours
Fabrication du PCB (4 couches)	5 jours
Câblage du PCB	2 jours
Debug	6 jours
Tests	3 jours
Délai moyen	30 jours

* Ces règles générales sont soumises à variations en fonction du projet



■ Processus du service ODM DTD



Votre développement produit

■ Utilisation d'un Computer On Module ?

Le Computer On Module est une carte qui intègre dans un format très compact un processeur et chipset X86 avec des fonctions basiques. Ce format de carte vous permet alors de vous concentrer sur la seule réalisation d'une carte réceptrice également appelée carte "métier" qui rassemblera votre électronique ainsi que les entrées /sorties dont votre produit a besoin.

Les bénéfices apportés par l'utilisation d'un Computer On Module sont les suivants :

- Intégration, maintenance et mise à jour matériel sont simplifiés à l'extrême.
- Réduction du temps de développement de votre produit.
- Diminution du risque d'erreur dans vos choix technologiques lors de votre développement.
- Déclinaison aisée de votre produit en plusieurs versions pour constituer sans investissement financier supplémentaire une gamme de produit complète.
- Réduction du coût de votre développement.
- Accroissement de la pérennité de votre produit.

■ Nos prestations

Le support que nous proposons pour les produits de la gamme Computer On Module est composé de 3 phases :

Phase 1 : Fourniture de la documentation

Nos ingénieurs technico-commerciaux et supports techniques vous mettent à disposition les documents suivants :

- Schémas électroniques de référence
- Règles de bases pour le développement de votre carte réceptrice
- Schéma de routage d'une carte réceptrice standard (PCB) (fichier ORCAD)

Phase 2 : Support technique pour votre développement

Nos ingénieurs technico-commerciaux et supports techniques vous accompagnent dans le développement de votre carte réceptrice.

- Nos ingénieurs sont présents auprès de vos équipes dès le début de votre projet afin de vous accompagner dans votre développement et vos validations.
- Nous vous proposerons de vérifier les schémas électroniques et de routages de votre carte réceptrice avant réalisation de vos premiers PCB.
- Dans le cas où votre électronique le nécessite, nous réaliserons un BIOS spécifique et nous pourrons vous proposer une adaptation de système d'exploitation embarqué.

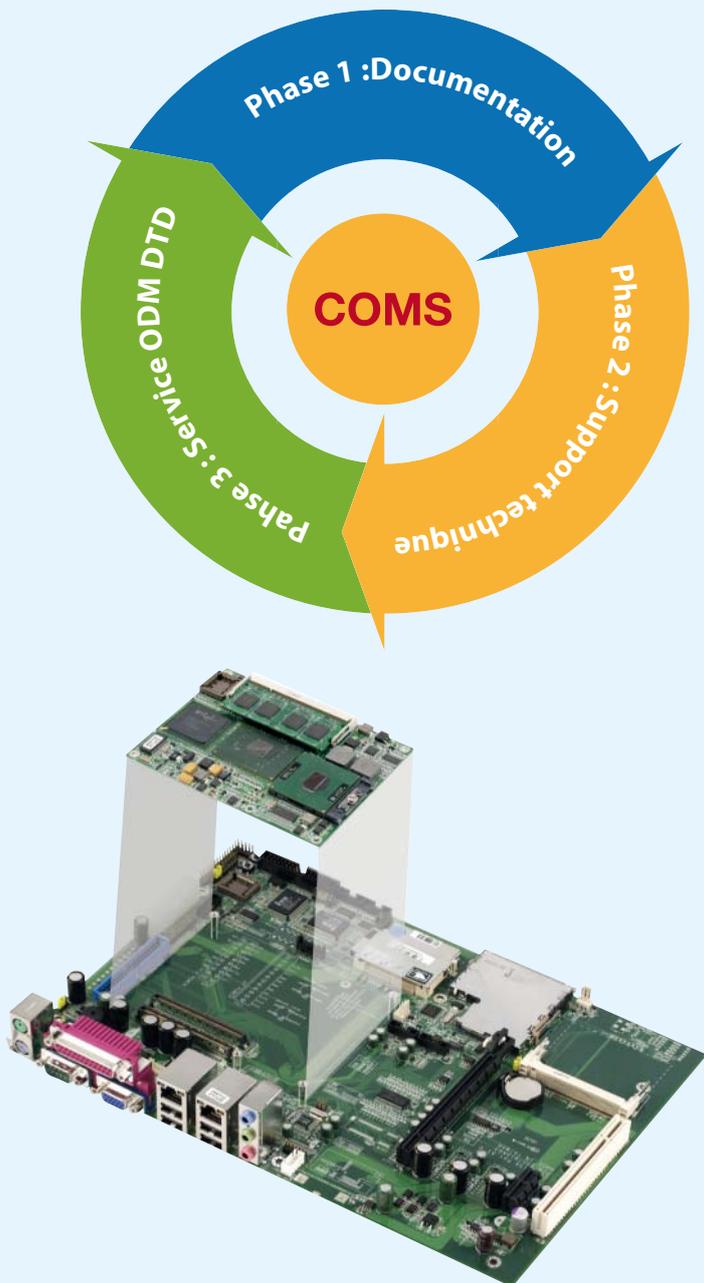
Phase 3 : Service ODM DTD

Nous vous proposons d'externaliser l'étude et la production de votre carte réceptrice, si après notre analyse ou à votre demande, vous ne pouvez pour des raisons de compétences interne, de disponibilités de vos équipes ou de délai trop court mener à bien votre développement.

Ce service est mis en oeuvre par notre équipe qui après analyse et étude de vos spécifications et contraintes (électronique et mécanique) vous proposera de mener à bien l'étude, la réalisation d'un prototype, la certification et l'industrialisation de votre carte réceptrice. Notre service ODM DTD est proposé pour des projets de 100 pièces à plusieurs milliers de pièces.

- ODM DTD est conçu pour minimiser le temps de développement et la mise sur le marché de votre produit.
- Nos ingénieurs travailleront avec vos équipes afin de déterminer avec détails les spécifications de votre future carte réceptrice (électronique et mécanique).
- Après validation de ces spécifications, la R&D du fabricant réalisera un prototype de votre carte réceptrice sous 30 jours ouvrés.
- Ce service vous permet de réduire vos ressources internes pour la conception de la carte réceptrice et de les concentrer à d'autres tâches.
- La réduction du temps de mise sur le marché de votre produit vous permettra d'augmenter vos chances de succès et d'accroître vos parts de marchés.

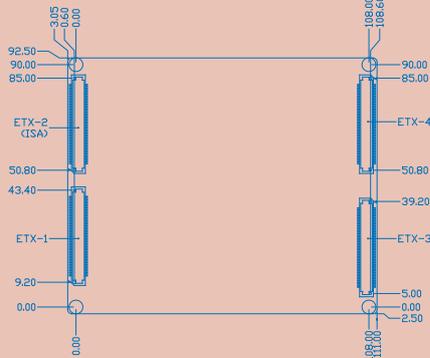
En fonction de vos ressources et du temps dont vous disposez pour votre développement, vous pourrez sélectionner notre service ODM DTD.



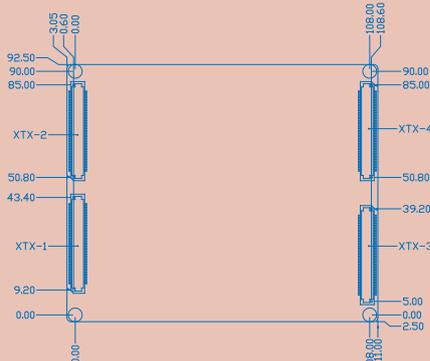
Modules ETX, XTX et COM Express

Plans mécanique des formats ETX/XTX/COM Express

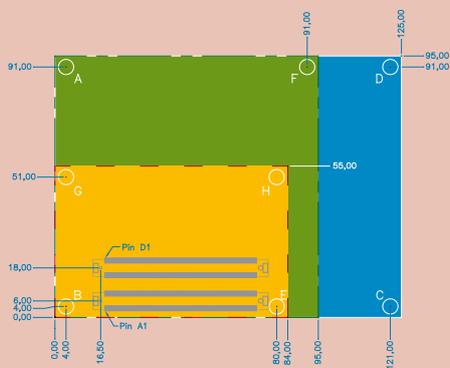
Dimensions Module ETX



Dimensions Module XTX



Dimensions Module COM Express



Couleur	Form Factor	Dimensions (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
■	Basic	125 x 95	V	V	V	V	V	—	—	—
■	Compact	95 x 95	V	V	—	—	V	V	—	—
■	Ultra (Nano)	84 x 55	—	V	—	—	V	—	V	V

Matrice pour le choix de la carte réceptrice

Module ETX

Module	Carrier Board	TF-ECB-901A-A10 304,8 x 210mm	TF-ECB-901A-A10-01 304,8 x 210mm
	ETX-CX700M		—
ETX-855		V	—
ETX-821		V	—
ETX-701 Rev.A		—	V
ETX-700 Rev.A		—	V
ETX-700 Rev.B		—	V
ETX-945GSE		V	V

Module XTX

Module	Carrier Board	TF-ECB-910A-A10 343,84 x 243,84mm	TF-ECB-910A-A10-01 343,84 x 243,84mm
	XTX-945		—
XTX-945GSE		—	V
XTX-915		V	—

Module COM Express

Module	Carrier Board	TF-ECB-915A-A10 304,8 x 210mm	TF-ECB-915A-A10-01 304,8 x 210mm	TF-ECB-916M-A10 243,84 x 243,84mm	TF-ECB-916M-A10-01 243,84 x 243,84mm	TF-ECB-916M-A10-02 243,84 x 243,84mm	TF-ECB-951D-A10 203 x 119mm	TF-ECB-951D-A10-01 203 x 119mm
	COM-45SP		—	—	—	V	—	—
COM-965		—	—	—	V	—	—	—
COM-690T		—	—	—	V	—	—	—
COM-945 Rev.A2.0		—	—	—	V	—	—	—
COM-945 Rev.A1.0		—	V	—	—	—	—	—
COM-945GSE		—	—	—	—	V	—	—
NanoCOM-U15		—	—	—	—	—	—	V
COM-U15		—	—	—	—	—	V	—
COM-915 Rev.B1.0		—	V	—	—	—	—	—
COM-915 Rev.A2.0		—	—	V	—	—	—	—
COM-915 Rev.A1.0		V	—	—	—	—	—	—

Guide de sélection des modules ETX et XTX

■ ETX CPU Modules



Model	ETX-CX700M	ETX-855	ETX-821	ETX-701	ETX-LN	ETX-945GSE
Form Factor	ETX					
CPU	Onboard VIA C7™ / Eden™ (V4 Bus)	Intel® (Socket 478-based) Pentium® M / Celeron® M	Intel® (Socket 478-based) Pentium® M / Celeron® M	Onboard AMD Geode™ LX series	Onboard Intel® Atom™	Onboard Intel® Atom™
Chipset	VIA C7™ / Eden™ (V4 Bus) + CX700M	Intel® 855GME + ICH4	Intel® 852GM + ICH4	AMD Geode™ LX + CS5536	Intel® Atom N450/D410/D510 + ICH8M	Intel® 945GSE + ICH7M
Memory Type	DDR II 400/533	ECC DDR 266/333	DDR 200/266	DDR 333/400	DDRIII 800	DDRII 400/533
Max.Memory Capacity	1GB, DDR II SODIMM x 1	1GB, DDR SODIMM x 1	1GB, DDR SODIMM x 1	1GB, DDR SODIMM x 1 DDR333 : 1GB, DDR400 : 512MB	4GB, DDRIII SDRAM	200-pin DDRII SODIMM x1, Max. 2 GB
Watchdog Timer	255 levels					Generates a time-out system reset
Ethernet	Realtek RTL8139DL, 10/100 Base-TX	Intel® 82562ET, 10/100 Base-TX	Intel® 82562ET, 10/100 Base-TX	Realtek RTL8139DL, 10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	Intel® EP82562ET, 10/100Base-TX
VGA/LCD Controller	VIA CX700M integrated	Intel® 855GME integrated	Intel® 852GM integrated	AMD LX processor integrated	nc	Intel® 945GSE integrated
Video Output	CRT, DVI, LVDS, LCD, TV-out	CRT, LVDS, LCD, TV-out	CRT, LVDS, LCD, TV-out	CRT, LVDS, LCD, TTL LCD	CRT, LVDS, LCD	
Audio	Realtek ALC888	Realtek ALC655	Realtek ALC655	Realtek ALC203	nc	
USB Port	USB2.0 x 4					
Serial Port	COM 1/2					2
Parallel Port	SPP/EPP/ECP x 1					1
HDD Interface	PATA x 1 (Two devices), SATA x 2	PATA x 2 (Four devices)	PATA x 2 (Four devices)	CompactFlash™ Type I Slot x 1 PATA x 2 (Four devices), SATA x 2	PATA x 1 SATA x 2	PATA x 1 (two devices), SATA II x 2 (on module)
Expansion Slot	8-bit/16-bit ISA 32-bit PCI x 4 DVI Port x 1 Video Capture Port x 1 SMBus x 1, I2C x 1	8-bit/16-bit ISA 32-bit PCI x 4 SMBus x 1 I2C x 1	8-bit/16-bit ISA 32-bit PCI x 4 SMBus x 1 I2C x 1	8-bit/16-bit ISA 32-bit PCI x 4 SMBus x 1 I2C x 1	PCI x4 ISA	32-bit PCI x 4 8-bit/16-bit ISA SMBus x 1 I2C x 1
Power Requirement	+5V					+5V DC
Operating Temperature	32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C)					
MTBF (Hours)	90,000	130,000	110,000	127,000	nc	98,000
Dimension (L x W)	4,5" x 3,75" (114 x 95mm)					

■ XTX CPU Modules



Model	XTX-945	XTX-945GSE	XTX-915	XTX-U15B	XTX-965
CPU	Intel® Core™ 2 Duo / Core™ Duo / Celeron® M (Socket-M based)	Intel® Atom™ N270	Intel® (socket 478-based) Pentium® M / Celeron® M	Intel® Atom™ Z530P / Z510P	Intel® Core™ Duo™
Chipset	Intel® 945GME + ICH7M	Intel® 945GSE + ICH7M	Intel® 915GME + ICH6M	Intel® SCH US15WP	Intel® GME965 + ICH8M
Memory Type	DDRII 400/533/667	DDRII 400/533	DDRII 400/533	DDRII 400/533	DDII 400/533/667
Max.Memory Capacity	2GB, DDRII SODIMM x 1	2GB, DDRII SODIMM x 1	2GB, DDRII SODIMM x 1	2GB, DDRII SDRAM	2GB, DDRII SDRAM
Watchdog Timer	255 Levels				
Ethernet	Intel® EP82562ET, 10/100Base-TX	Intel® EP82562ET, 10/100Base-TX	Intel® EP82562ET, 10/100Base-TX	nc	nc
VGA/LCD Controller	Intel® 945GME integrated	Intel® 945GSE integrated	Intel® 915GME integrated	nc	nc
Video Output	CRT, LVDS, LCD, TV-out			CRT, LVDS, LCD	CRT, LVDS, LCD, TV-out
USB Port	USB2.0 x 6			nc	nc
Serial Port	COM 1/2			nc	nc
Parallel Port	1			nc	nc
HDD Interface	PATA x 1 (Two devices), SATA II x 2			PATA x 1, SATA x2 (Optional)	PATA x 1, SATA x 3
Expansion Slot	PCI-Express [x1] x 4 ; 32-bit PCI x 4 ; LPC interface x 1 ; SMBus x 1 ; I2C x 1			PCI x 4, PCI-Express [x1] x4	PCI x 4, PCI-Express [x1] x 4
Power Requirement	+5V				
Operating Temperature	32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C)				
MTBF (Hours)	100,000	104,000	90,000	nc	nc
Dimension (L x W)	4,5" x 3,75" (114 x 95mm)				

*Pour vos besoins en température étendue, nous contacter

Guide de sélection Modules COM Express

COM Express Modules



Model	COM-45SP	COM-965	COM-690T/E	COM-945	COM-45GS
Form Factor	COM Express, Basic Module, Pin-out Type II				
CPU	Intel® Core™ 2 Duo / Celeron®M (Socket-P based)	Intel® Core™ 2 Duo / Celeron®M (Socket-P based)	AMD Turion™ / Sempron™ (S1 Socket)	Intel® Core™ 2 Duo / Core™ Duo / Celeron®M (Socket-M based)	Onboard Intel® Core™ 2 Duo / Celeron®M (SFF, 22x22 mm)
Chipset	Intel® GM45 + ICH9M	Intel® GME965 + ICH8M	AMD M690T / E + SB600	Intel® 945GME + ICH7M	Intel® GS45 + ICH9M SFF
Memory Type	Non-ECC DDRIII 800/1066	Non-ECC DDRII 533/667	Non-ECC DDRII 667/800	Non-ECC DDRII 400/533/667	
Max.Memory Capacity	8GB, DDRIII SODIMM x 2 Supports dual-channel function	4GB, DDRII SODIMM x 2 Supports dual-channel function	4GB, DDRII SODIMM x 2 Supports dual-channel function	2GB, DDRII SODIMM x 1	8 GB, DDRIII SODIMM x 2, supports dual-channel function
Watchdog Timer	255 levels				Fintek F75111
Ethernet	Intel® 82567, Gigabit Ethernet	Intel® 82566, Gigabit Ethernet	Intel® 82573L, Gigabit Ethernet	Intel® 82573L, Gigabit Ethernet	Intel® 82567LM, 10/100/1000Base-TX
VGA/LCD Controller	Intel® GM45 integrated	Intel® GME965 integrated	AMD M690T/E integrated	Intel® 945GME integrated	Intel® GS45 integrated
Video Output	CRT, LVDS, LCD, TV, DisplayPort, HDMI, DVI	CRT, LVDS, LCD, TV	CRT, DVI, LVDS, LCD, TV (TV Function only for COM-690T)	CRT, LVDS, LCD, TV	CRT, LVDS, LCD, TV, DisplayPort, HDMI, DVI
Audio	High definition audio interface				
USB Port	USB2.0 x 8				
HDD Interface	SATA II x4 ; PATA x 1 (Two devices)	SATA II x3 ; PATA x 1 (Two devices)	SATA II x4 ; PATA x 1 (Two devices)	SATA II x 2	PATA x 1 (One device) SATA II x 3
Expansion Slot	PCI-Express [x16] x1 PCI-Express [x1] x5 32-bit PCI x4, LPC bus x1 SMBus x1, I2C x1	PCI-Express [x16] x1 PCI-Express [x1] x5 32-bit PCI x4, LPC bus x1 SMBus x1, I2C x1	PCI-Express [x8] x1 PCI-Express [x1] x3 32-bit PCI x4, LPC bus x1 SMBus x1, I2C x1	PCI-Express [x16] x1 PCI-Express [x1] x3 (82801GBM) PCI-Express [x1] x5 (82801GHM) (Optional) 32-bit PCI x4, LPC bus x1, SMBus x1, I2C x1	PCI-Express [x16] x1] PCI-Express [x1] x5 32-bit PCI x4 LPC bus x1 SMBus x1 I2C x1
Power Requirement	+8.5V~+19V				
Operating Temperature	32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C)				
MTBF (Hours)	nc	100,000	90,000	100,000	85,000
Dimension (L x W)	4,92" x 3,75" (125 x 95mm)				



Model	COM-945GSE	COM-U15	NanoCOM-U15	COM-QM57/HM55
Form Factor	COM Express, Compact Module, Pin-out Type II			
CPU	Onboard Intel® Atom™ N270	Onboard Intel® Atom™ Z530 / Z510	Onboard Intel® Atom™ Z530 / Z510	Intel® Arrandale BGA CPUs
Chipset	Intel® 945GSE + ICH7M Intel®	System Controller Hub US15W	Intel® System Controller Hub	Intel® QM57/HM55
Memory Type	Non-ECC DDRII 400/533	Non-ECC DDRII 400/533	Non-ECC DDRII 533	DDRIII 800/1066
Max.Memory Capacity	2GB, DDRII SODIMM x 1	2GB, DDRII SODIMM x 1	1GB, on board	8GB SODIMM
Watchdog Timer	255 levels			
Ethernet	Intel® 82574L, Gigabit Ethernet	Intel® 82574L, Gigabit Ethernet	Intel® 82574L, Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet
VGA/LCD Controller	Intel® 945GSE integrated	Intel® System Controller Hub US15W integrated	Intel® System Controller Hub US15W integrated	nc
Video Output	CRT, LVDS, LCD, TV	LVDS, LCD, SDVO	LVDS, LCD, SDVO	CRT, LVDS, LCD, TV, HDMI, DVI
Audio	High definition audio interface			
USB Port	USB2.0 x 8			
HDD Interface	PATA x 1 (Two devices) SATA II x 2	PATA SSD on board (Master device), Max. 4GB PATA x 1 (One device) or SATA II x 1	PATA SSD on board (Master device), Max. 4GB, SATA II x 1	PATA x 1 SATA x 4
Expansion Slot	PCI-Express [x1] x 3 (82801GBM) PCI-Express [x1] x5 (82801GHM) (Optional) 32-bit PCI x4, LPC bus x1, SMBus x1, I2C x1	4-bit SDIO : Multiplexed with GPIO pins PCI-Express [x1] x 1 LPC bus x 1 SMBus x 1	4-bit SDIO : Multiplexed with GPIO pins PCI-Express [x1] x 1 LPC bus x 1 SMBus x 1	PCI-Express [x16] x 1 PCI-Express [x1] x 6 PCI x 4
Power Requirement	+8.5V~+19V	+8.5V~+19V	+4.75V to +14.7V	+12V
Operating Temperature	32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C)			
MTBF (Hours)	100,000	nc	nc	nc
Dimension (L x W)	3,75" x 3,75" (95 x 95mm)	3,75" x 3,75" (95 x 95mm)	3,31" x 2,17" (84 x 55mm)	4,92" x 3,75" (125 x 95mm)

*Pour vos besoins en température étendue, nous contacter

Gamme de produits proposés

■ Cartes mères industrielles

Notre offre produits couvre l'ensemble des standards disponibles sur le marché.

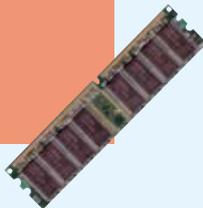
- Carte mère EPIC : 115x165mm
- Carte mère ultra compact - 3"1/2 : 146 x 101,6mm
- Carte mère compact - 5"1/4 : 203x146mm
- Carte mère ATX : 305mm x 204mm
- Carte mère PC/104 -PCI/104 -PC/104+ : 90x96mm
- Carte mère Mini-ITX : 170x170mm
- Carte mère Nano-ITX : 120x120mm
- Carte mère demi-longueur : 185x122mm
- Carte mère pleine-longueur : 338x122mm
- Carte mère pour applications militaires et télécoms



■ Modules mémoire vive et mémoire de stockage SSD

Pour vos problématiques de stockage ou d'hébergement de système d'exploitation, nous avons des solutions.

- Compact Flash
- Disque Dur Flash (SSD)
- Module mémoire Industriel (Disk On Module) et SATA DOM



■ PC Industriels

Depuis l'apparition des systèmes embarqués durcis, de nombreuses expertises dans différents domaines ont permis à AAEON de concevoir une large gamme de systèmes (plus de 15 modèles) répondant aux contraintes suivantes.



- Durci : Résiste aux chocs, aux vibrations et températures ambiantes élevées
- Fiable : Fonctionne sans ventilateur, aucune contrainte mécanique, sans câblage interne
- Performant : Processeur Intel Core 2 Duo Mobile, Pentium M / Celeron M, ATOM, AMD Geode
- Embarqué : Tension d'entrée de 9V à 30V DC, Disque Flash ou CompactFlash en option
- OS supportés : Windows 7, CE, XPE, XP et Linux

■ Firewall / VPN / DVR

Nous vous proposons une gamme complète de matériels informatique réseaux pour les applications VPN, Firewall, VOIP, serveur de fichier, serveur vidéo, e-commerce. Disponibles en version de table, en rack 1U/2U, ces produits peuvent être personnalisés à vos besoins (couleurs, logo, paramétrage du BIOS...).



■ Modules d'affichage et cartes de pilotage

Pour vos cartes mères mais également pour votre électronique propriétaire, nous vous proposons les dernières technologies d'affichage.

- De 1,8" à 56"
- LCD rétro-éclairé par LED
- Haute luminosité
- Faible consommation
- Multi-affichages, sortie DVI, HDMI, LVDS
- Température de fonctionnement étendue : -30°C / +85°C



■ Modules d'impression

Les drivers Windows 2000/XP/Vista et Linux sont disponibles pour ces imprimantes thermiques. La gamme de température en fonctionnement peut aller de -20°C à + 60°C et les interfaces RS232 et USB permettront de s'adapter à vos contraintes. La plupart de ces imprimantes intègrent les polices de caractères EUROPE, RUSSE, US, JAPON, CHINE, ASCII et de nombreuses polices de codes barres (UPC-A UPC-E JAN13 JAN8 CODE128 ITF). Les opérations pour le chargement du papier sont très simples et des options sont disponibles : présentoir de papier, éjection, découpage papier, fonction retour papier.



■ Modems et modules M2M

Vous souhaitez rendre vos produits communicants, nous avons des modules et modems qui vous permettront de réduire vos temps de développements (interface Mini-Card / Mini PCI-E) et USB.

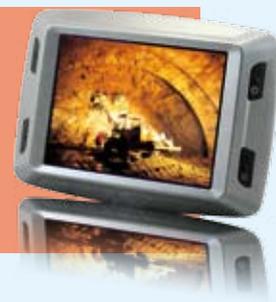


- Réseaux 2G & 3G
- Modules Wifi / Bluetooth Technologie SIP
- Technologie GPS

■ Panels PC

Nous vous proposons une gamme complète de produits pour un large éventail d'applications.

- Gamme Médicale
- Gamme Robuste
- Gamme Marine
- Gamme Supervision
- Gamme Tout-Terrain
- Gamme Panel PC IP65 6 faces INOX
- Gamme Militaire



Équipements Scientifiques



■ Qui sommes nous ?

Équipements Scientifiques, distributeur à valeur ajoutée créé en 1963, certifié ISO 9001 version 2000 est spécialisé dans la distribution de composants électroniques, d'équipements de tests & mesure et de systèmes informatiques. Fort de ces 70 collaborateurs et d'un chiffre d'affaire supérieur à 30 millions d'Euros, ES fait désormais partie de ces entreprises promotrices d'innovations.



■ Conseils Avant-vente :

- Une équipe d'ingénieurs technico-commerciaux compétents et expérimentés à votre écoute
- Fiches techniques, notes d'applications, catalogues, sites Web
- Tests et démonstrations des produits
- Prêts d'évaluation des produits et solutions
- Prix compétitifs
- Formations

■ Services Après-vente :

- 01 47 95 99 70 - msi@es-france.com
- Garantie retour ateliers de 2 ans pour la plupart de nos produits
- Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 5 ans
- Hors garantie : Devis sous 8 jours, 4 semaines en moyenne pour le délai de réparation

■ Nos compétences dédiées à l'activité Computer On Module :

Notre département MSI (Modules et Systèmes Informatiques) vous propose une équipe locale et expérimentée pour vous apporter le support nécessaire à cette technologie. Notre présence auprès de nombreux industriels Français depuis 1963 nous a donné une culture de l'efficacité technique sans s'éloigner de vos priorités économiques.

Nos ingénieurs sont présents auprès de vos équipes dès le début de vos projets afin de vous accompagner dans le développement et la validation de vos produits. Lors de votre production, nous restons à votre écoute pour répondre efficacement aux problématiques qui pourraient se présenter pendant l'intégration de vos produits.

Notre ERP et les passerelles Internet avec l'usine d'AAEON nous permettent de sécuriser vos productions, vos déploiements mais également le SAV sur plusieurs années de vos produits.

Par ailleurs, si après notre analyse ou à votre demande vous ne pouvez pour des raisons de compétences interne, de disponibilités de vos équipes ou de délai trop courts, mener à bien votre développement, nous vous proposerions d'externaliser l'étude et la production de votre produit sous 30 jours ouvrés avec notre service ODM DTD. Ce service est mis en oeuvre par notre équipe qui, après analyse et étude de vos spécifications et contraintes (électronique et mécanique), vous proposera de mener à bien l'étude, la réalisation de prototypes, les certifications et l'industrialisation de votre produit. Notre service ODM DTD est proposé pour des projets de 100 pièces à plusieurs milliers de pièces.

Nous sommes à votre service depuis des décennies pour vous apporter le meilleur de l'informatique industrielle.

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

Département Modules et Systèmes Informatiques

127 rue de Buzenval - 92380 Garches

Tél. : 01 47 95 99 80 - Fax : 01 47 01 16 22

email : msi@es-france.com

Site web: www.es-france.com



Département
Modules & Systèmes
Informatiques

Autres Départements

TESTS, ENERGIE, MESURES

☎ 01 47 95 99 45

email : tem@es-france.com

INFORMATIQUE & VIDEO

☎ 01 47 95 99 71

email : infor@es-france.com

OPTIQUES & TELECOMS

☎ 01 47 95 99 90

email : opt@es-france.com

RESEAUX SANS FIL

☎ 01 47 95 99 50

email : reseaux@es-france.com

BIO TESTS & INDUSTRIES

☎ 01 47 95 99 90

email : bio@es-france.com

COMPOSANTS & MODULES

☎ 01 47 95 99 84

email : comp@es-france.com

RF & HYPERFREQUENCES

☎ 01 47 95 99 60

email : hyper@es-france.com

MODULES & SYSTEMES INFORMATIQUES

☎ 01 47 95 99 80

email : msi@es-france.com